ДОКУМЕМИНИСТЕРСТВО НАУКИЛИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информация о владельце: ФИО: Сенченю павел распраственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Должность: Проректор по учебной СМСКИЙ ГО СУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ Дата подписания: 10.11.2023 12:27:22

Уникальный программный ключ:

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

27e516f4c088deb62ba68945f4406e13fd454355

(ТУСУР)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Направление подготовки / специальность: 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Направленность (профиль) / специализация: Микроэлектроника и твердотельная электроника

Форма обучения: очная

Факультет: Факультет электронной техники (ФЭТ) Кафедра: Кафедра физической электроники (ФЭ)

Kypc: 3 Семестр: 5

Учебный план набора 2020 года

Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Виды учебной деятельности	5 семестр	Всего	Единицы
Лекционные занятия	36	36	часов
Практические занятия	18	18	часов
Лабораторные занятия	16	16	часов
Самостоятельная работа	38	38	часов
Подготовка и сдача экзамена	36	36	часов
Общая трудоемкость	144	144	часов
(включая промежуточную аттестацию)	4	4	3.e.

	Формы промежуточной аттестация	Семестр
Экзамен		5

1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

1. Целью освоения дисциплины является формирование базовых знаний в области технологии электронной компонентной базы, позволяющего выпускнику обладать предметноспециализированными компетенциями.

1.2. Задачи дисциплины

- 1. Данная учебная дисциплина имеет перед собой задачу показать физическую сущность используемых в микро- и наноэлектронике технологических процессов и привить обучающемуся комплексный научный подход к выбору методов и процессов формирования электронной компонентной базы.
- 2. Результатом обучения должно быть приобретение компетенций по основным, базовым процессам технологии для применения их в научных исследованиях, разработке и производстве изделий микро- и наноэлектроники.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).

Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля).

Индекс дисциплины: Б1.В.02.07.

Реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения

	петенции и индикаторы их достижения			
Компетенция	Индикаторы достижения компетенции			
Универсальные компетенции				
-	-			
Общепрофессиональные компетенции				
-	-			
Профессиональные компетенции				
ПКР-7. Способен выполнять работы по	ПКР-7.1. Знает технологические основы производства материалов и изделий электронной техники			
технологической подготовке производства	ПКР-7.2. Умеет выполнять отдельные технологические операции по производству материалов и изделий электронной техники			
материалов и изделий электронной техники	ПКР-7.3. Владеет навыками построения технологических маршрутов изготовления материалов и изделий электронной техники			
ПКР-8. Способен организовывать метрологического	ПКР-8.1. Знает основные стандарты по метрологическому обеспечению изделий электронной техники			
обеспечение	ПКР-8.2. Умеет проводить измерения в соответствии со стандартами			
производства материалов и изделий электронной техники	ПКР-8.3. Владеет навыками работы на стандартном измерительном оборудовании			

ПКС-2. Способен к	ПКС-2.1. Знает основное технологическое оборудование для
применению	производства изделий электронной техники
современных	
технологических	
процессов и	ПКС-2.2. Умеет обосновывать выбор технологического процесса и
технологического	оборудования для его реализации
оборудования на	
этапах разработки и	
производства изделий	ПКС-2.3. Владеет навыками практической работы на технологическом
микроэлектроники и	оборудовании
твердотельной	
электроники	

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
5 семестр
1 Введение, цели и задачи дисциплины
2 Производственная чистота, гигиена и безопасность
3 Литографические процессы в технологии электронных средств
4 Технология плазменных процессов
5 Технология формирования тонкопленочных покрытий методом термического испарения в
вакууме
6 Ионно-плазменные методы получения тонких пленок
7 Технология формирования тонкопленочных ИМС
8 Технологические процессы изготовления тонкопленочных ИМС
9 Технология сборочных процессов